

**ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE***Avviso appalto aggiudicato*

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dr. Roberto Dell’Orso

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Lavorazione di Flip-Chip Bump Bonding per l’upgrade del tracciatore dell’esperimento CMS per la Sezione di Pisa – CIG: 5423734EDF - Atto GE n. 10092/2013

II.1.5) CPV: 31642000-8

II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 335.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del d.P.R. 633/72)

IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 57, comma 3, lett. a) D.lgs. n. 163/2006

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

V.1) Data di aggiudicazione: 14.07.2014 (GE 10342)

V.2) Numero offerte ricevute: 2

V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Fraunhofer IZM – Gustav Meyer Allee 25 – 13355 Berlin (Germany)

VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010

VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 31.07.2014

Direttore a.i. direzione affari contrattuali  
Luigi Giunti

TX14BGA622 (A pagamento).

